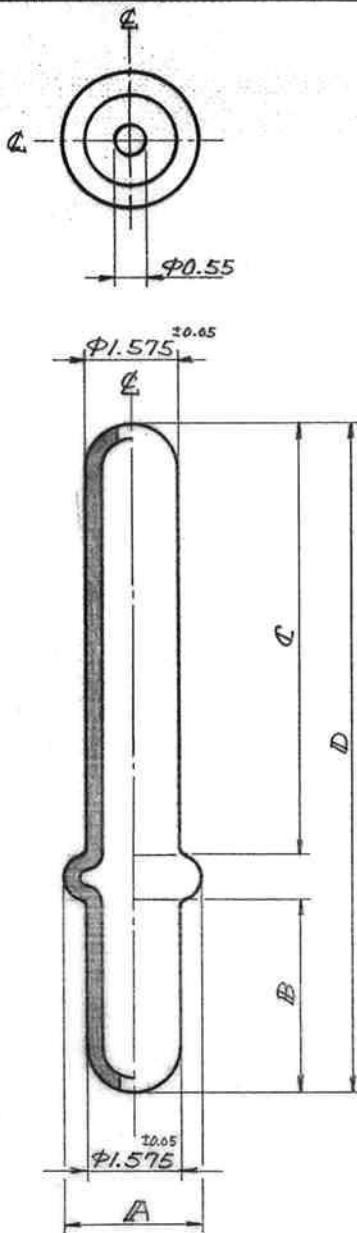


ENG. NO. SD-R62-*

EDP NO. 16-06-00**



注記

1. 推奨プリント基板穴径: $\phi 1.65^{+0.05}$

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

角度 ANGLE	$\pm 3^\circ$	16-06-0010	R62-5	$\phi 2.55$	3.68	7.1	11.55	錫メッキ(3 μ MIN.)
30 以上 OVER	± 0.3							
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	± 0.25	16-06-0011	-4	$\phi 2.28$	3.18	10.15	14.1	錫メッキ(3 μ MIN.)
10 未満 UNDER	± 0.2	16-06-0004	R62-3	$\phi 2.29$	3.18	7.11	11.05	錫メッキ(3 μ MIN.)
一般公差 GENERAL TOLERANCES		EDP NO.	ENG. NO.	A	B	C	D	メッキ仕様 備考

材料 MATERIAL		貴銅		MOLEX MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上 FINISH		長参照		EDP NO. 16-06-00**	
適用電線範囲 WIRE RANGE				ENG. NO. SD-R62-*	
被覆外径 INS. RANGE				REV D	
DRAWN BY		CHK'D BY		TITLE 名称: BEAD PIN	
APP'D BY		DATE		尺 度 SCALE 8-1	